

半導体材料事業

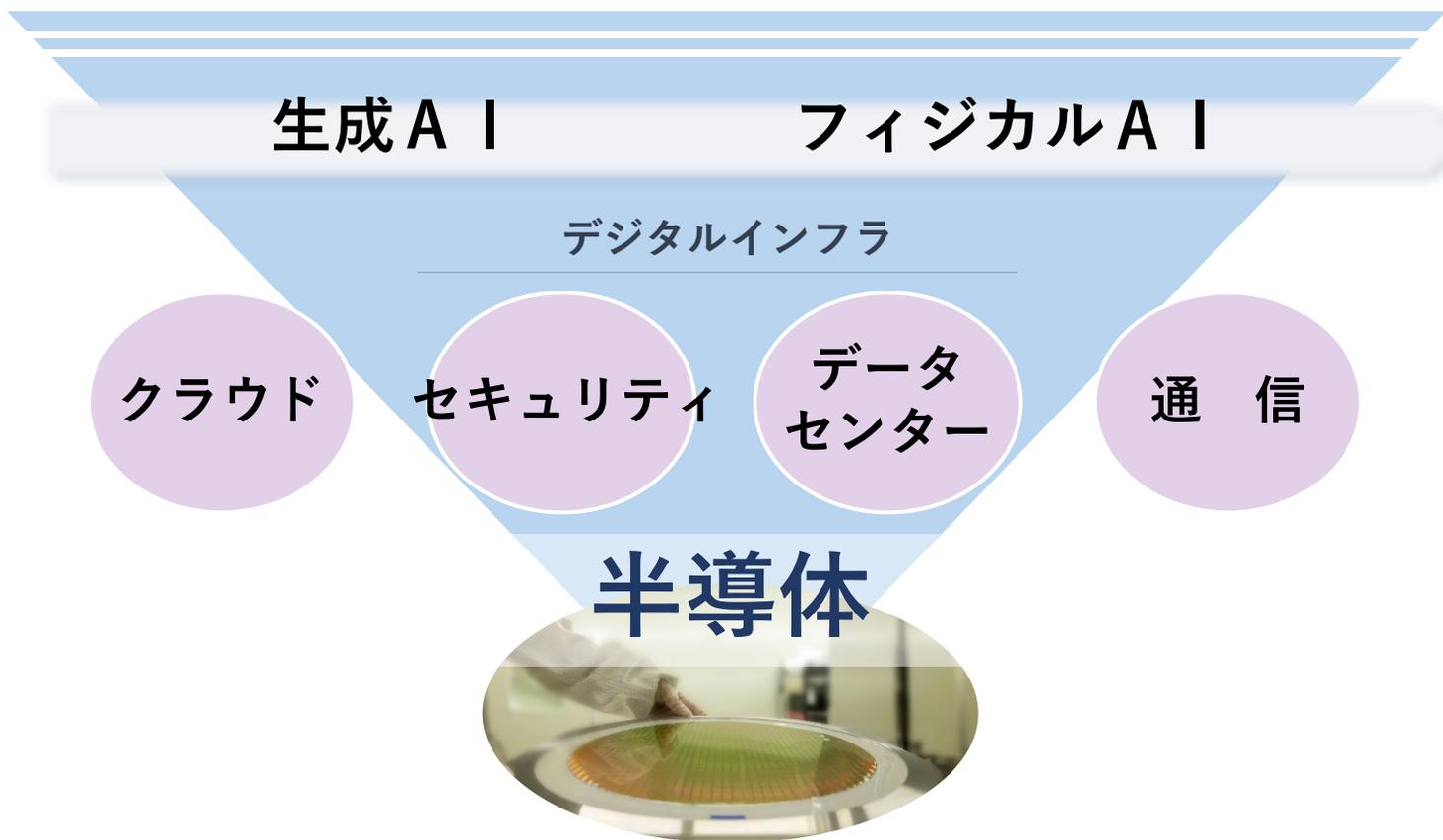
半導体材料のさらなる拡大

2026年2月26日

【証券コード 4401】



A I の普及・進化で、拡大が続く半導体市場

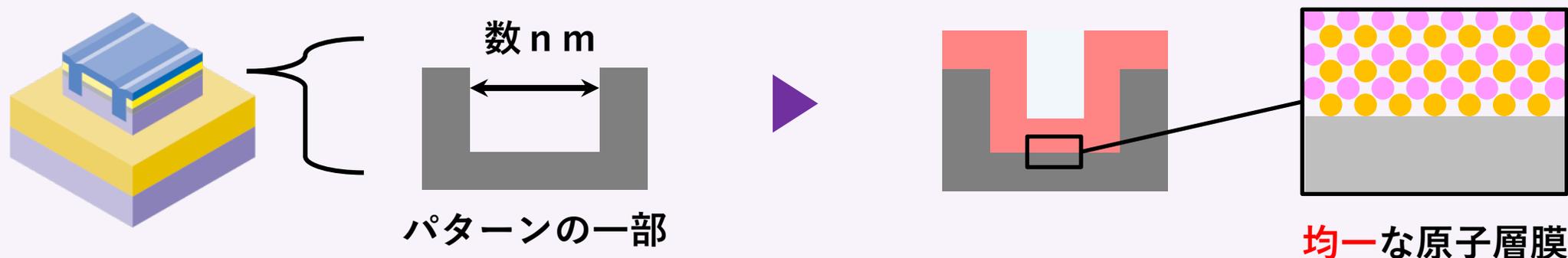


半導体のさらなる進化で、材料ニーズは今後ますます拡大

合成技術



成膜評価技術



技術と信頼の融合、革新の連鎖で変化に応える素財

半導体集積化

先端パッケージ

光電融合、AI特化チップ



半導体用ALD材料

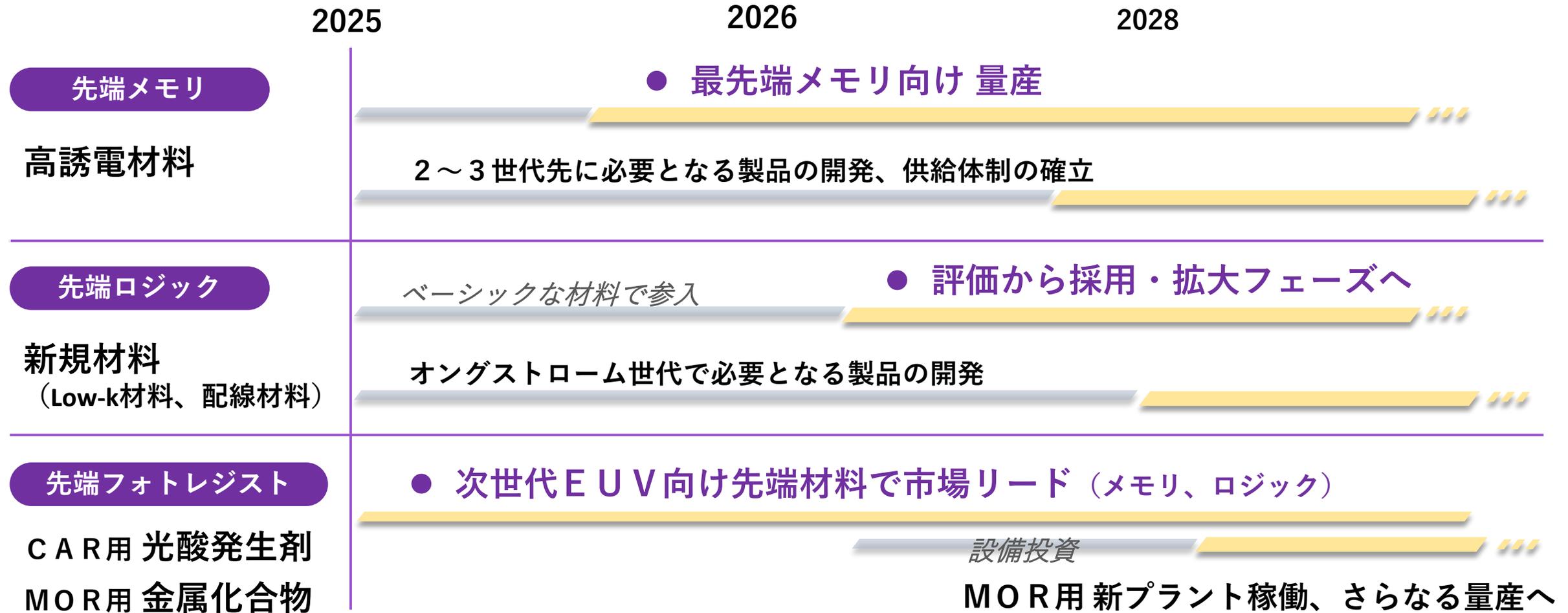
半導体リソグラフィ材料

高誘電材料

新規Low-k材料、配線材料

CAR用 光酸発生剤
MOR用 金属化合物

*CAR：化学増幅型レジスト、MOR：金属酸化物レジスト



最先端の半導体を支えるキーマテリアルを拡大、次世代開発で微細化をリード

先端パッケージの技術革新を実現する後工程材料

半導体集積化

先端パッケージ

光電融合、AI特化チップ

TIM (銅)
熱インターフェース材料

ハイブリッドボンディング

光電用接着剤

etc.

ADEKAの素材が活躍する領域

ADEKA

半導体後工程材料

特殊樹脂 × フィラー・添加剤 など
(配合設計の技術)

低温焼結銅ペースト
(接合/電極形成など)

ポリマー樹脂

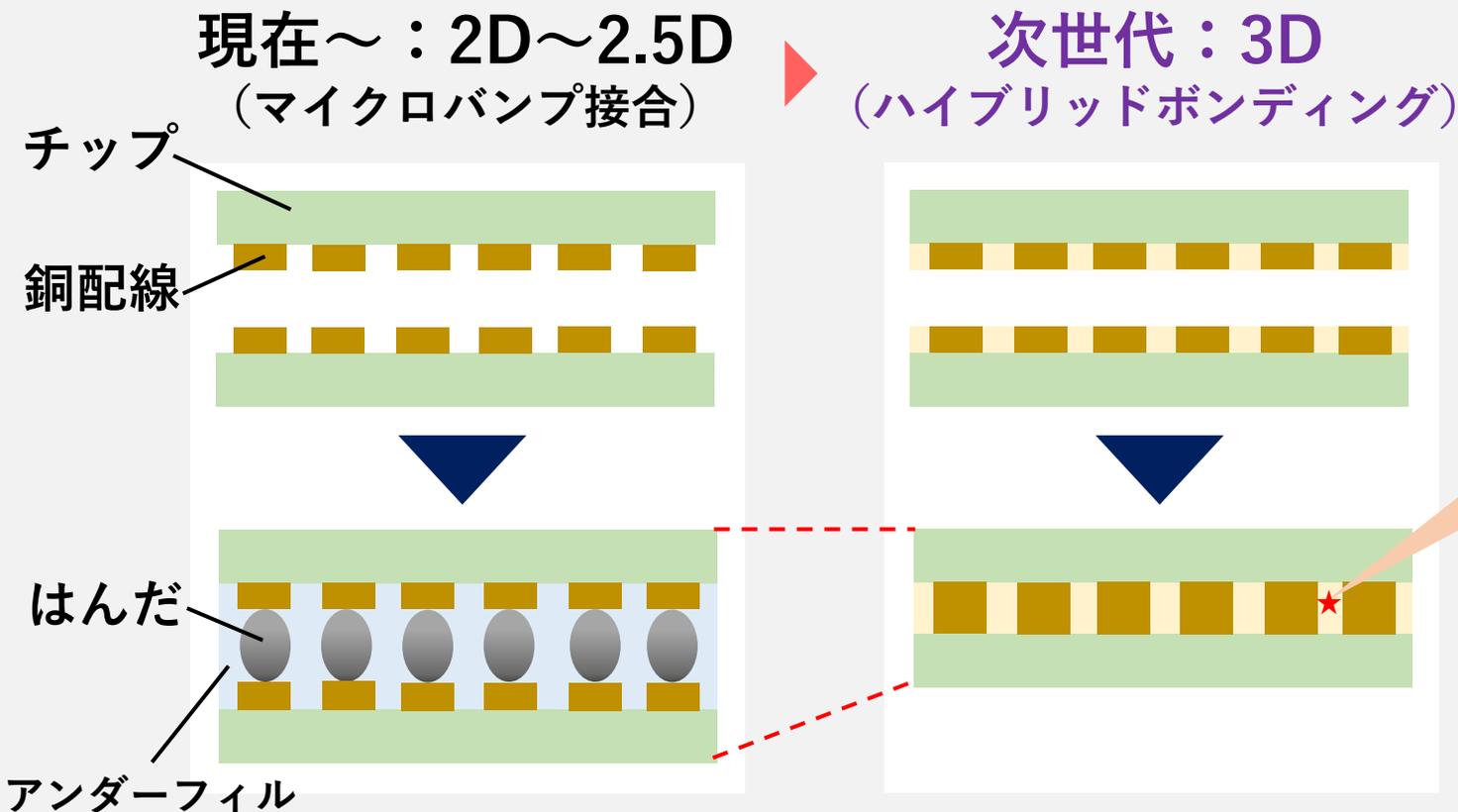
光・熱硬化樹脂
(接合/構造接着)

応力緩和、高熱伝導

低温接合 (200°C)、ボイド抑制

高精度、リフロー耐性

半導体パッケージの技術革新を担う新しい接合技術



銅配線同士をはんだで接続し
隙間をアンダーフィルで埋める

銅配線同士を直接接続できる

ポリマー樹脂(開発中)

- 横浜国立大学と共同研究 (NEDO)
- 当社の既存技術を応用

- ✓ 複雑化が進む後工程プロセスの負担を低減
- ✓ 従来より10分の1以上の省スペース化で高性能&省電力を実現

次世代メモリ/ロジックICの
高積層化/高集積化に貢献



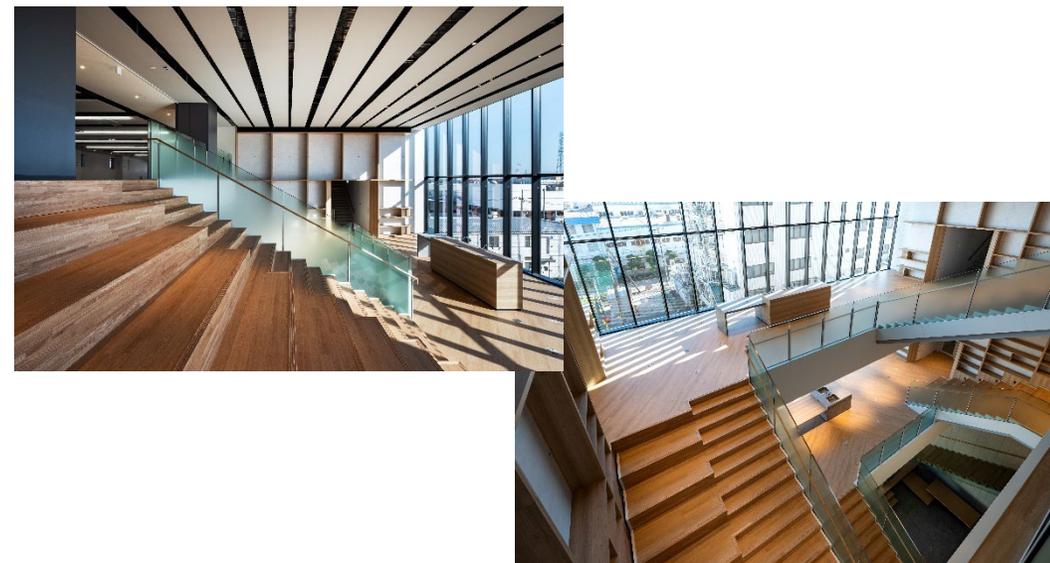
後工程の技術的なメガトレンドを捉え、スピーディーな製品開発と応用展開で事業拡大

2026年夏、いよいよ始動 イノベーティブな製品創出を加速



実験室 **1.5**倍（現行比）

クリーンルーム **2.5**倍（現行比）



所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼20

規模 | 地上7階建

（実験室、クリーンルーム、分析室、会議室他）

The logo for ADEKA features a stylized letter 'A' on the left, composed of a red upper half and a blue lower half. To the right of the 'A' is the word 'DEKA' in a bold, red, italicized sans-serif font.

ADEKA

Add Goodness